

技術詞彙表

本技術詞彙表載有本文件所使用的與本公司及其業務有關的若干技術詞彙的釋義。該等詞彙及其涵義未必與該等詞彙的標準行業涵義或用法相符。

「2.5D及3D封裝」	指	半導體封裝技術，其中多顆芯片以高密度互連：在2.5D封裝中，芯片並排放置於中介層頂部；在3D封裝中，芯片垂直堆疊，並使用硅通孔或類似技術實現互連
「ABF」	指	味之素積層膜(Ajinomoto Build-up Film)，一種廣泛應用於集成電路封裝基板增層的有機介電材料
「AGV」	指	自動導引運輸車
「AI」	指	人工智能
「APC」	指	高級過程控制
「APLAC」	指	亞太實驗室認可合作組織
「APS」	指	高級計劃排程
「細菌內毒素」	指	一種來源於革蘭氏陰性菌細胞壁的致熱物質，以內毒素單位計量，若存在於注射用藥品中可能引起發熱或其他不良反應
「起動力」	指	使注射器針筒內活塞開始移動所需的力
「複合年增長率」	指	複合年增長率
「藥審中心」	指	國家藥品監督管理局藥品審評中心，負責中國藥品臨床試驗申請和上市許可申請的技術審評
「CDMO」	指	合約開發及生產機構，即按合約基準向製藥公司提供藥物開發及生產服務的公司
「芯粒」	指	一種模塊化半導體裸片，旨在與單個封裝內與其他裸片互連以形成完整系統
「ChP」	指	中國藥典
「A類註冊」	指	在藥品審評中心為活性藥物成分、輔料及主要包裝材料和容器所維護的註冊平台上，註冊狀態標示為「A」，表示相關產品已通過適用的關聯審評審批或單獨審評審批

技術詞彙表

「CMMM」	指	中華人民共和國國家標準GB/T 39116-2020規定的智能製造能力成熟度模型的常用縮寫，用於評估既定成熟度等級下的智能製造能力
「CNAS」	指	中國合格評定國家認可委員會
「CoWoS」	指	基板上晶圓芯片封裝，一種半導體封裝技術，先將芯片安裝於硅晶圓中介層上，再附接至基板上
「CPO」	指	共封裝光學，一種將光引擎與計算芯片集成於同一封裝內以提高數據傳輸速度和效率的技術
「丹納法」	指	一種連續玻璃管拉制工藝，其中熔融玻璃流經旋轉、傾斜的中空芯棒，並從其末端拉製成管
「DCS」	指	集散控制系統，一種採用中央監控下的聯網控制器，以監測及控制生產過程中的關鍵運行參數的過程控制系統
「脫片」	指	玻璃容器內表面形成並脫落的薄玻璃片(稱為片層)，可能污染內容物並損害藥品的安全性和質量
「去熱原」	指	從藥品包裝組件中破壞或去除熱原(包括細菌內毒素)
「DMF」	指	藥品主文件，向美國食品藥品監督管理局提交的、載有關於藥物生產、加工、包裝或儲存中所用設施、工序或材料的機密及詳細資料的備案文件
「EP」	指	歐洲藥典
「ERP」	指	企業資源計劃
「EU」	指	內毒素單位，細菌內毒素活性的計量單位
「人眼安全激光玻璃」	指	通常摻鉕的激光玻璃，發射波長約1.5–1.6 μm的激光，該波長的光在到達視網膜前被角膜和晶狀體吸收，從而降低眼睛受傷風險
「料道」	指	一種溫控通道，用於將熔融玻璃從熔爐輸送並調節至成型設備
「FSC」	指	森林管理委員會，一個國際非營利組織，制定負責任的森林管理標準以及林產品產銷監管鏈認證標準

技術詞彙表

「GB/T 2828.1-2012」	指	一項中國國家標準，等同於ISO 2859-1，規定按接收質量限(AQL)索引、用於逐批計數檢驗的抽樣方案
「GB/T 35596-2022」	指	一項中國國家標準，規定耐熱吹制硼硅玻璃器皿的技術要求和試驗方法
「GHG」	指	溫室氣體
「微晶玻璃」	指	通過玻璃受控結晶形成的材料，同時含有晶相和殘餘玻璃相，兼具玻璃和陶瓷的性能
「玻璃基板」	指	以玻璃作為其核心或基材，並經進一步加工以納入所需電氣互連結構的半導體封裝基板
「滑動力」	指	注射過程中維持注射器筒體內活塞膠塞連續移動所需的力
「GMP」	指	藥品生產質量管理規範
「料滴」	指	從熔爐出口切下或滴落的熔融玻璃團，用於送入模具成型
「一級」	指	根據ISO 720國際標準，於121°C測試的玻璃顆粒最高耐水性等級
「HBM」	指	高帶寬存儲器，一種存儲器技術，其中多個動態隨機存取存儲器(DRAM)芯片垂直堆疊，並與處理器一起置於同一中介層上，以實現高數據傳輸帶寬
「HC1」	指	根據ISO 4802國際標準，玻璃容器內表面耐水性的最高等級
「HGB1」	指	根據ISO 719國際標準，在98°C下測試的玻璃顆粒耐水性的最高等級
「高硼硅玻璃」、 「中硼硅玻璃」和 「低硼硅玻璃」	指	分別含有約12%或以上、8%至低於12%以及5%至低於8%氧化硼(B ₂ O ₃)的硼硅特種玻璃，氧化硼含量越高，熱膨脹越低，抗熱震性和化學穩定性越高
「HPC」	指	高性能計算，即利用超級電腦及服務器集群，高速處理大量數據並執行複雜運算
「耐水性」	指	衡量玻璃與水或水溶液接觸時抵抗鹼性物質浸出的能力的指標，是藥品包裝用玻璃化學穩定性的關鍵指標
「ILAC」	指	國際實驗室認可合作組織

技術詞彙表

「I/O」	指	輸入／輸出，指數據於芯片與記憶體、其他芯片或外部裝置之間的傳輸
「中介層」	指	一種由硅、玻璃或其他材料製成，位於一個或多個芯片與封裝基板之間的中間層，在多個芯片之間提供高密度電氣互連
「離子交換強化」	指	一種玻璃強化工藝，其中玻璃表面附近的較小鹼金屬離子被熔鹽浴中的較大鹼金屬離子置換，形成表面壓應力層，從而提高機械強度
「IS」	指	行列機，一種包括多個獨立運行的相同工位，每個工位通過制瓶工序將玻璃料滴成型為藥用模製瓶的成型機
「ISO 4803」	指	一項規定實驗室儀器所用硼硅酸鹽玻璃管的尺寸和材料規格等要求的國際標準
「ISO 9001」	指	一項規定適用於各行業組織的質量管理體系要求的國際標準
「ISO 13485」	指	一項規定專門適用於醫療器械質量管理體系要求的國際標準
「ISO 15378」	指	一項規定專門適用於藥品直接接觸包裝材料的質量管理體系要求的國際標準
「ISO/IEC 17025」	指	一項規定檢測和校準實驗室的能力、公正性和一致運作的通用要求的國際標準
「ISO 50001」	指	一項規定建立、實施、維護和改進能源管理體系要求，使組織能夠實現能源績效持續改進的國際標準
「JP」	指	日本藥典
「kWh」	指	千瓦時，一種電能單位；1千瓦時=1,000瓦時
「魯爾鎖」	指	一種標準化的旋鎖機構，用於將針頭或其他組件固定到注射器尖端
「MES」	指	製造執行系統
「MF」	指	主文件，向加拿大衛生部提交的載有關於藥物製造、加工或包裝所用特定工序或成分的保密資料的申報文件
「MWh」	指	兆瓦時，一種電能單位；1兆瓦時=100萬瓦時

技術詞彙表

「盒裝托盤」	指	一種無菌包裝形式，其中盛放單個容器的托盤(巢)被封閉在外層硬質容器(盒)內，可直接用於自動化灌裝線
「料泡」	指	一種初步的中空熔融玻璃體，通常形成於其在模具內通過壓縮空氣膨脹成最終形狀之前
「PCB」	指	印刷電路板，即由導電及絕緣層壓合而成的板材，芯片封裝及其他電子元件乃安裝於其上並相互連接
「PFS」	指	預灌封注射器系統；就我們的產品而言，指供應予製藥廠商以供填充藥品的玻璃注射器針筒及相關組件，該等組件通常於經過適用的清洗、硅化、滅菌及包裝工序後供應
「PLC」	指	可編程邏輯控制器，一種工業計算機控制系統，用於監測輸入設備並執行存儲的程序以控制輸出設備的狀態
「PMC」	指	生產及物料控制
「PRC GMP」	指	中國《藥品生產質量管理規範》
「R&D」	指	研究與開發
「RDL」	指	重布線層，形成於芯片或基板上的一層或多層圖案化金屬互連層，用以重新分佈輸入／輸出連接，並提供橫向電氣佈線
「RGV」	指	有軌導引運輸車
「RTU」	指	即用型無菌直接接觸包裝材料(如西林瓶和卡式瓶)，已由製造商預清洗、去熱原和滅菌，供應給客戶可直接灌裝而無需進一步處理，通常採用盒裝托盤或托盤配置以防止玻璃間接觸
「硅化處理」	指	在玻璃注射器針筒或類似容器內表面塗覆薄層硅酮塗層，以減少摩擦並促進活塞膠塞順暢移動
「鈉鈣玻璃」	指	一種主要由二氧化硅、純鹼和石灰組成的玻璃，與硼硅特種玻璃相比，具有較高的熱膨脹性和較低的化學穩定性及耐水解性
「固定針」	指	製造期間永久固定在注射器尖端的針，區別於在使用時才將針連接到魯爾鎖注射器

技術詞彙表

「無菌保證水平」	指	滅菌後單件產品仍為非無菌狀態的概率，表示為 10^{-n} ； 10^{-6} 是無菌注射劑產品的標準基準
「結石」	指	玻璃內未溶解的固態晶體夾雜物，通常源於未熔化的原材料或耐火材料侵蝕
「條紋」	指	玻璃內由化學成分、密度或折射率的局部差異引起的細條紋或層狀結構
「基板」	指	在封裝內機械支撐半導體芯片並將芯片與外部端子電氣連接的平台
「SVR」	指	支持向量回歸，一種源自支持向量機的機器學習技術，通過在數據點周圍規定誤差範圍內擬合回歸函數來預測連續數值
「噸二氧化碳當量」	指	噸二氧化碳當量，一種標準單位，用於根據各種溫室氣體的全球升溫潛能值比較其排放量
「特種玻璃」	指	其材料組成或加工經專門設計，以實現超越通用玻璃的特定功能或性能特徵的玻璃
「TGV」	指	玻璃通孔，一種在玻璃基板中形成的通孔，經金屬化後提供基板兩側之間的垂直電氣互連
「USP」	指	美國藥典
「維洛法」	指	一種連續玻璃管拉制工藝，其中熔融玻璃流過垂直芯軸與周圍環形件之間的間隙，形成沿近水平路徑拉出的管子
「WMS」	指	倉儲管理系統